

Electronics Precision cleaning

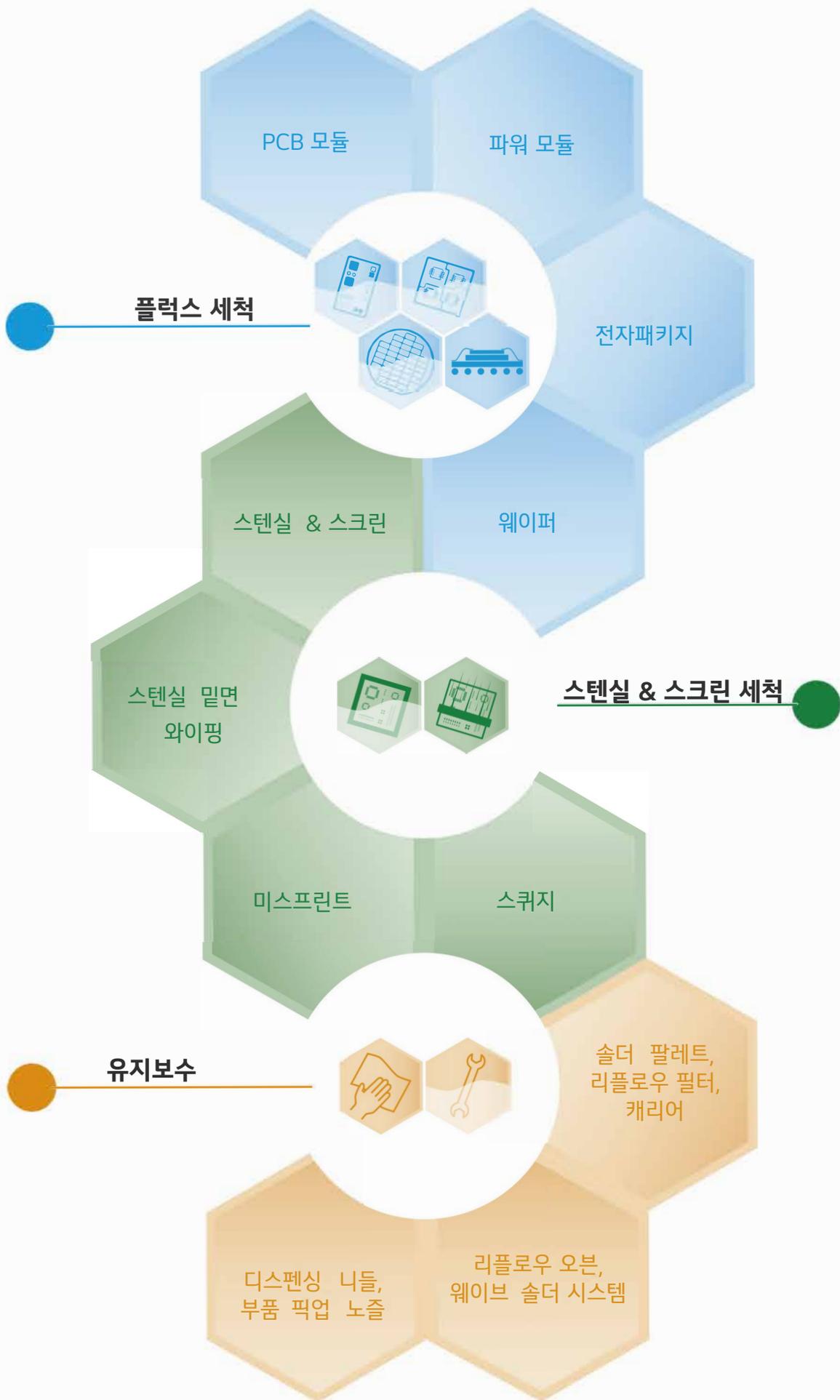
독일 제스트론 친환경 세척제

(주)에치씨코퍼레이션

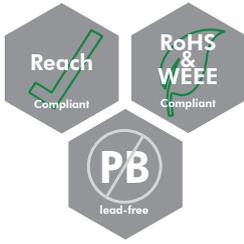
Tel. 02-515-6671

hc@hccorp.kr

www.hccorp.kr



환경, 보건, 및 안전 규정



모든 제스트론 세척제는 RoHS I, II & III/WEEE, GHS/CLP 및 REACH 를 준수하며 SVHC 또는 S.I.N. 목록에 있는 물질을 포함하고 있지 않습니다. 저희 세척제는 가장 친환경적이고 작업자의 사용에 안전한 원료로 사용되고 있습니다.

추가 정보 문의는 아래의 연락처로 문의 하십시오
Email : hc@hccorp.kr / Tel : 02-515-6671

세척 기술 및 브랜드

Solvent Technology - ZESTRON



ZESTRON® 세척제 제품군은 High-end 세척 용도에 맞게 개발된 솔벤트 기반 제품입니다. 다양한 오염물질의 제거를 위해 넓은 세척 공정 범위에서 적용이 가능하고, 일반적인 심플한 알코올이나 할로겐 솔벤트에 비해 긴 Bath 수명을 가지고 있고 여러 안전 기준에 준한 최적의 세척제 제품입니다.

FAST® Technology - ATRON



ATRON® 세척제 제품군은 Fast Acting Surfactant Technology 를 기반으로 하는 새로운 계면활성제 입니다. 이 세척제 제품은 짧은 접촉 시간에도 탁월한 세척 성능을 보이며 일반적 계면활성제에 비해 높은 Bath 적재 용량을 제공합니다.

MPC® Technology - VIGON



VIGON® 세척제 제품군은 Micro Phase Cleaning Technology 를 기반으로 한 세척제이며, 다양한 세척 용도에 맞게 넓은 세척 공정 범위에 적용이 가능합니다. 이 세척제 제품군은 수계 기반의 계면 활성제가 없는 세척제로 매우 긴 Bath 수명으로 인해 운영 비용을 감소시킬 수 있습니다. 또한 불연성이며 휘발성유기화합물(VOCs)의 수치도 매우 낮습니다.

Single-phase Technology - HYDRON



HYDRON® 세척제 제품군은 제한된 세척 공정을 취급하는데 있어서 뛰어난 세척 공정성을 제공하고 수계 기반의 용액이며 상분리가 되지 않은 세척제 입니다. 이 세척제 제품군은 용액 세척 후 헹굼 특성이 좋으며 운영비용을 감소하고 긴 Bath 수명을 위해 쉽게 필터링 할 수 있습니다.

추가 이용 가능한 세척제 제품 정보

» 기술 정보

세척제 제품의 물리적 데이터, 적용 분야,이점에 대한 정보

» 재료 호환성

부품, 세척 시료, 세척 장비와의 재료 호환성에 대한 정보

» 물질보건안전자료

구성요소, 취급 주의사항, 운송 및 보관방법에 대한 정보

» MPC® 기술

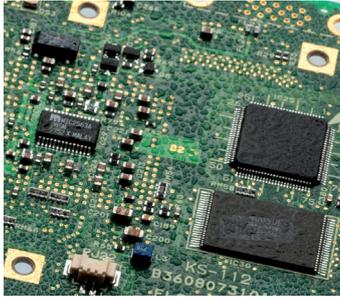
수계 기반 세척 기술에 대한 정보

» FAST® 기술

계면활성제 기반 세척 기술에 대한 정보

» HYDRON® 기술

수계 기반, Single-phase, 세척 기술에 대한 정보



PCBA 플렉스 세척

PCBA 플렉스 세척을 위해 다양한 수계 및 용제 기반의 세척제를 사용할 수 있습니다. PCBA 플렉스 세척을 위한 세척 제품군에는 여러 가지 기술이 적용되어 있어 모든 일반적인 세척 공정에서 최신 솔더 페이스트와 플렉스에 뛰어난 세척 성능을 제공합니다. 저희 세척제는 알칼리성뿐만 아니라 중성의 세척제가 있으며 어떤 종류의 부품과 기판에도 우수한 재료 호환성 특성을 가지고 있습니다.

제품 기술	세척제	세척 용도					세척 공정 타입				
		PCB (FR4) 모듈	플렉서블 PCB	세라믹 하이브리드	알루미늄 기반	스프레이	조임파	침전형 스프레이	CO-solvent / HFE	진공 단일 챔버	매뉴얼 (수리)
MPC® (수계 기반)	VIGON® A 201	●	●	●		●					
	VIGON® N 600	●	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® N 640	●	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® N 680	●	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® PE 180	●	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® PE 190A	●	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® A 200	●		●		●	●	●			
	VIGON® US	●		●			●	●			
	VIGON® A 250	●		●		●	●	●			
FAST® (수계 기반, 계면 활성제)	ATRON® AC 205	●	●	●		●					
	ATRON® AC 207	●	●	●		●					
	HYDRON® WS 400	●	●			●					
Solvent (솔벤트 기반)	ZESTRON® FA+	●	●	●	●		●	●			
	ZESTRON® VD	●	●	●	●				●		
	ZESTRON® CO 150	●	●	●	●			●			
	ZESTRON® DW	●	●	●	●	●	●		●		
	VIGON® EFM	●		●	●						●

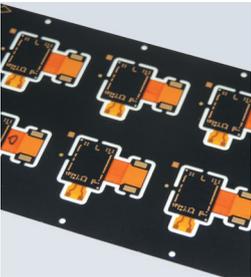
● 세척제 전용 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션을 위해 특별히 개발된 세척제 제품
 ● 적용 가능한 세척제 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션에 사용될 수 있는 세척제 제품

세척 응용 제품 및 이점



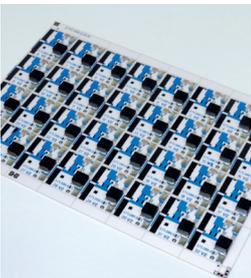
PCB 기반

PCBA는 솔더링 이후 디플렉스를 요구합니다. 제스트론 세척제는 뛰어난 세척 성능을 제공하고, 코팅 프로세스를 위한 준비 상태로 만들어 주며, 세척을 통해 전기화학적 마이그레이션과 같은 불량을 방지하여 제품의 장기 신뢰성을 보장하게 합니다. 저희 세척제 제품에는 낮은 갭의 칩 부품에도 탁월한 세척 및 행금 성능을 제공하는 세척제들이 있으며 일반적 PCBA 재료 및 특정 폴리머와 우수한 재료 호환성을 제공하는 세척제들도 있습니다.



플렉서블 PCB 기반

연성기판보드의 세척 요건은 일반적인 FR4/Multilayer 기판과 유사합니다. 대부분의 경우 솔더링 이후 코팅 또는 몰딩 공정 전에 디플렉스가 필요하며 이와 같은 특징 외에도 유연한 기본 재질과의 재료 호환성 특성도 필수적입니다. 제스트론은 폴리이미드와 같은 일반적인 연성기판보드 재료와 우수한 호환성을 가지는 세척제를 제공합니다.



세라믹 하이브리드 기반

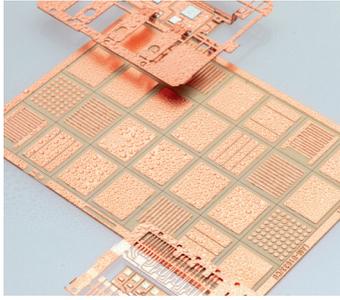
세라믹 하이브리드 기반 제품은 장기 신뢰성과 두꺼운 필름 표면에 잠재적인 전기화학적 이온마이그레이션 감소를 위해 코팅 또는 몰딩 전에 플렉스 세척을 요구합니다. 세척 성능 외에도 필름 구조와의 재료 호환성은 모든 세척제의 필수 요구 사항입니다. 제스트론은 Resist 페이스트, Glass 패시베이션, 전도성 페이스트와 같은 필름 구조의 재료와 호환성이 좋은 다양한 플렉스 세척제를 제공하고 있습니다.

환경, 보건, 및 안전 규정



모든 제스트론 세척제는 RoHS I, II & III/WEEE, GHS/CLP 및 REACH 를 준수하며 SVHC 또는 S.I.N. 목록에 있는 물질을 포함하고 있지 않습니다. 저희 세척제는 가장 친환경적이고 작업자의 사용에 안전한 원료로 사용되고 있습니다.

추가 정보 문의는 아래의 연락처로 문의 하십시오
Email : hc@hccorp.kr / Tel : 02-515-6671



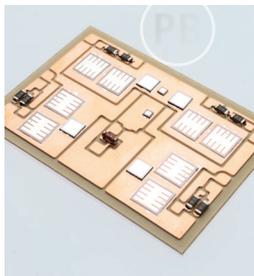
전력 전자 부품 플렉스 세척

파워모듈, DCB, 리드프레임, Discrete 디바이스 등 전력 전자 부품을 위한 제스트론의 세척제 제품 포트폴리오는 다양한 기술을 특징으로 하는 수계 및 용제 기반 세척제를 모두 포함하며 뛰어난 세척 성능과 물질 호환성이 좋은 특징을 가지고 있습니다. 알칼리성 및 pH 중성 세척제는 민감한 금속, 다이, 절연층과 같은 재료와도 호환성이 뛰어나고 Cu 기판의 산화막을 제거하여, 후속 와이어 본딩 또는 몰딩을 위한 최상의 상태를 제공합니다.

제품 기술	세척제	세척 용도					세척 공정 타입			
		파워 LED	DCB / IGBT 파워모듈	리드프레임 / Discretes	스프레이	초음파	침전형 스프레이	원심 분리	Co-Solvent / HFE	진공 단위 챔버
MPC® (수계 기반)	VIGON® PE 200	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® PE 215N	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® PE 180	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® PE 190A	●	●	●	●	●	●			
	VIGON® N 600	●	●	●	●	●	●	●		
	VIGON® A 200		●	●	●	●	●			
	VIGON® A 201	●			●	●				
	VIGON® A 250	●			●	●	●			
HYDRON® (상분리 없음, 수계 기반)	HYDRON® SE 220	●	●	●		●	●	●		
	HYDRON® SE 230A	●	●	●		●	●	●		
FAST® (수계 기반, 계면 활성제)	ATRON® AC 205	●			●					
	ATRON® AC 207	●	●	●	●					
Solvent (솔벤트 기반)	ZESTRON® FA+	●	●	●		●	●			
	ZESTRON® DW	●	●	●	●	●				●
	ZESTRON® VD			●						●
	ZESTRON® CO 150		●	●				●		

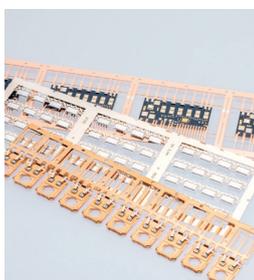
- 세척제 전용 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션을 위해 특별히 개발된 세척제 제품
- 적용 가능한 세척제 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션에 사용될 수 있는 세척제 제품

세척 응용 제품 및 이점



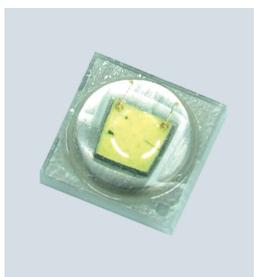
DCB / 파워 모듈 / IPM / IGBT

전력 전자 부품 모듈 세척의 주요 요구사항은 다이 어태치 및 Heat sink 솔더링 이후 잔존하는 플럭스를 제거함과 동시에 재료 호환성 좋아야 하고 산화막 제거가 용이해야 합니다. 제스트론의 세척제 제품은 뛰어난 세척 성능과 Cu 표면의 산화막 제거가 가능하고 기판이 밝고 윤이 나며 재산화물을 방지합니다. 또한 민감한 금속(Cu, Ni, Al, Au, Ag) 및 칩 표면과의 호환성이 좋으며 와이어 본딩 및 몰딩과 같은 후속 공정에서 높은 품질을 확인할 수 있습니다.



리드프레임 / Discrete

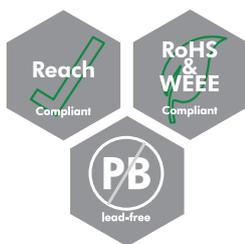
리드프레임과 Discrete 부품은 와이어 본딩 또는 몰딩 공정에 앞서 다이 접합 후 플럭스 제거가 필요하게 됩니다. 제스트론의 세척제는 뛰어난 플럭스 세척 성능을 보이며, 특히 Clip 본딩 기술에 종종 적용되고 솔더링 온도가 높은 High Pb 솔더 합금 세척에도 세척 효과가 뛰어납니다. 또한 재료 호환성 및 Ni, Ag 와 같은 민감한 금속과의 재료 호환성도 좋으며 Cu 표면의 산화막 제거도 가능합니다.



고출력 LED / 자동차용

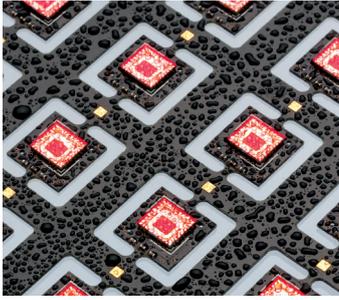
자동차 전장 제품의 고출력 LED를 세정 시 플럭스 제거 성능과 함께 재료 호환성 및 광량에 미치는 영향은 필수적 고려 사항입니다. 제스트론의 세척제는 다이 접합 후 잔여물을 모두 안정적으로 제거하여 높은 와이어 본딩 품질 수준과, 우수한 광량과 긴 LED 수명을 가질 수 있도록 합니다. 또한 후속 공정 또는 End 고객이 사용 시 화학 물질 배출을 방지하고 모든 변환 계층과 호환됩니다.

환경, 보건, 및 안전 규정



모든 제스트론 세척제는 RoHS I, II & III/WEEE, GHS/CLP 및 REACH 를 준수하며 SVHC 또는 S.I.N. 목록에 있는 물질을 포함하고 있지 않습니다. 저희 세척제는 가장 친환경적이고 작업자의 사용에 안전한 원료로 사용되고 있습니다.

추가 정보 문의는 아래의 연락처로 문의 하십시오
Email : hc@hccorp.kr / Tel : 02-515-6671



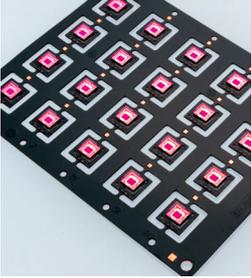
전자패키지 및 웨이퍼 세척

플립칩, SiP, CMOS 제품의 언더필 및 와이어 본딩이나 몰딩 전에 다이 접합 후 플럭스 세척에 초점을 맞춰 최신 전자패키지를 위한 수계 기반 및 용제 기반의 다양한 세척제를 제공하고 있습니다. 저희 세척제는 갭이 낮은 공간에서 우수한 세척 성능과 다양한 부품과의 재료 호환성을 제공합니다. 또한 와이어본딩 특성 및 언더필 보이드가 없고 언더필 젖음성 향상에 효과를 가져오며 웨이퍼 범프의 피팅 현상이나 몰드 후 계면박리 현상에 대한 예방을 가능하게 합니다.

제품 기술	세척제	세척 용도						세척 공정 타입				
		SiP	플립칩 BGA/ 2.5/3D TSV	BGA	단일 부품 예: CoB, MEMS	CMOS	웨이퍼	스프레이	초음파	침전형 스프레이	원심 분리	단일 혹은 일괄적 웨이퍼 공정
MPC® (수계 기반)	VIGON® N 600	●	●	●	●			●	●	●	●	
	VIGON® A 201	●	●	●	●	●		●				
	VIGON® A 250	●	●	●	●	●		●				
	VIGON® US	●	●	●	●	●			●	●	●	
HYDRON® (상분리 없음, 수계 기반)	HYDRON® SE 220	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	HYDRON® SE 230A	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
FAST® (수계 기반, 계면 활성제)	ATRON® AC 205	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	ATRON® AC 207	●	●	●	●			●				
Solvent (솔벤트 기반)	ZESTRON® FA+	●	●	●	●	●			●	●		

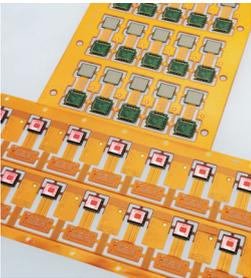
- 세척제 전용 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션을 위해 특별히 개발된 세척제 제품
- 적용 가능한 세척제 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션에 사용될 수 있는 세척제 제품

세척 응용 제품 및 이점



SiP / 2.3/3D TSV / 플립칩 / BGA / 단일 부품

와이어 본딩이나 언더필, 몰딩에 앞서 다이 접합 후 플럭스 세척은 매우 중요하며, 특히 TSV 나 범프 수가 많고, 갭이 매우 낮은 전자패키지의 플럭스 세척은 핵심 도전이 됩니다. 제스트론의 세척제는 20-30 μ m의 낮은 갭 공간에서의 우수한 모세관 현상 효과로 인해 세척 성능이 좋으며 또한 후속 언더필 공정을 위한 최적의 상태를 제공함으로써 언더필의 우수한 젖음 특성과 언더필 보이드 감소 효과를 가져오고 동시에 와이어 본딩의 품질과 몰드 접착력을 향상시킵니다.



CMOS / 카메라 모듈

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 세척은 다이 접합 후 플럭스 세척뿐만 아니라 파티클 제거를 요구합니다. 제스트론의 권장된 세척제는 우수한 세척 및 린스 성능을 제공함으로써 세정 후 오염물이나 세척제의 잔사가 남지 않습니다. 또한 표면으로부터 모든 입자가 제거되도록 하여 광학 기능(예: 카메라, 센서 등)의 고장을 방지합니다.



웨이퍼

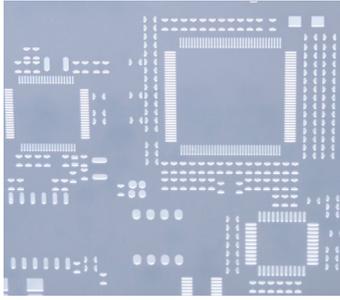
일반적으로 웨이퍼는 범프를 형성 후 플럭스 세척을 하게 됩니다. 제스트론은 범프 주위에 플럭스 잔류물이 남지 않는 수계 기반의 세척제를 제공하고 있습니다. 저희 세척제는 웨이퍼 범프 합금과의 재료호환성이 좋으며 범프에 피팅과 같은 어떠한 손상도 없습니다. 또한 BCB, Silicon Nitride 또는 폴리이미드와 같은 다양한 패시베이션과의 재료 호환성도 우수하며 사용시 단일 혹은 일괄적 웨이퍼 공정에서 사용하는 것을 권장하고 있습니다.

환경, 보건, 및 안전 규정



모든 제스트론 세척제는 RoHS I, II & III/WEEE, GHS/CLP 및 REACH 를 준수하며 SVHC 또는 S.I.N. 목록에 있는 물질을 포함하고 있지 않습니다. 저희 세척제는 가장 친환경적이고 작업자의 사용에 안전한 원료로 사용되고 있습니다.

추가 정보 문의는 아래의 연락처로 문의 하십시오
Email : hc@hccorp.kr / Tel : 02-515-6671



SMT 스텐실,스크린,미스프린트 세척

제스트론의 수계 기반 및 용제 기반의 세척제 제품들은 스텐실, 스크린에 남아있는 솔더페이스트를 제거하는데 용이합니다. 또한 SMT 접착제, 두꺼운 필름용 페이스트, 열 전도성 화합물을 제거를 위한 전용 세척제가 있으며, SMT 프린터의 스텐실 밀면 세척과 미스프린트 세척에 필요한 세척제를 제공하고 있습니다.

제품 기술	세척제	세척 용도								세척 공정 타입	
		플럭스	솔더페이스트	SMT 접착제	필름용 페이스트	열 전도성 화합물	스퀴지	스프레이	초음파	SMT 프린트 스텐실 밀면	매뉴얼
MPC® (수계 기반)	VIGON® SC 200	●	●	●			●	●	●	●	●
	VIGON® SC 202	●	●	●			●	●	●		
	VIGON® SC 210	●	●	●			●	●	●		
	VIGON® SC	●	●	●			●	●	●	●	
	VIGON® UC 160		●							●	
	VIGON® TC 150					●	●	●			
HYDRON® (상분리 없음, 수계 기반)	HYDRON® SC 300	●	●	●			●	●	●	●	●
Solvent (솔벤트 기반)	ZESTRON® SD 100		●				●	●		●	
	ZESTRON® SD 301	●	●	●	●		●	●		●	●
	ZESTRON® SW		●	●						●	
	ZESTRON® SD 300	●	●	●	●		●	●		●	●

- 세척제 전용 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션을 위해 특별히 개발된 세척제 제품
- 적용 가능한 세척제 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션에 사용될 수 세척제 제품

세척 응용 제품 및 이점



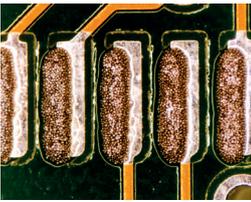
스텐실 / 스크린

제스트론의 스텐실 및 스크린용 세척제는 솔더페이스트, SMT 접착제, 두꺼운 필름 페이스트, 열전도성 화합물과 같은 여러 타입의 오염물을 제거하는데 용이합니다. 수계 및 용제 기반의 세척제는 자동화 세척 및 매뉴얼 세척용으로 사용 가능하며, 스테인리스강, 니켈, Pumpprint, Step 스텐실 및 나노 코팅된 스텐실과의 재료 호환성에도 우수합니다.



SMT 프린터 스텐실 밀면

제스트론은 SMT 프린터 제조사로부터 해당 프린터 장비에 세척제 사용이 승인된 전용의 수계 및 용제 기반 세척제를 제공합니다. 저희 세척제는 와이퍼 천의 젖음 특성 및 세척 성능이 우수하며 스텐실 밀면 세척 주기 사이에 인쇄 횟수를 증가시킬 수 있습니다. 따라서 세척제와 와이퍼 천의 소비량이 감소되고 동시에 신뢰할 수 있는 인쇄품질을 제공합니다.



미스프린트

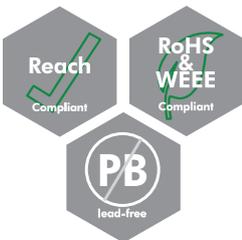
한쪽에 이미 솔더링된 양면 조립 보드에 페이스트가 잘못 인쇄된 경우 일반적으로 세척이 필요합니다. 미스프린트 세척을 위한 제스트론의 세척제는 한쪽면에 솔더링 되어있지 않는 솔더페이스트와 다른 한쪽면의 솔더링되어 남아 있는 플럭스 잔사를 제거합니다. 또한 이들 세척제의 특정 배합으로 스텐실 물질과의 재료호환성 특성이 우수합니다.



스퀴지

스퀴지에 기계적 손상 또는 남아있는 솔더 페이스트 잔류물은 인쇄품질을 저하시키는 결과를 초래할 수 있으므로 주의 깊게 보관하고 유지해야 합니다. 제스트론의 세척제는 솔더 페이스트를 안정적으로 제거하며 모든 일반적인 스퀴지 재료와 호환성이 좋습니다.

환경, 보건, 및 안전 규정



모든 제스트론 세척제는 RoHS I, II & III/WEEE, GHS/CLP 및 REACH 를 준수하며 SVHC 또는 S.I.N. 목록에 있는 물질을 포함하고 있지 않습니다. 저희 세척제는 가장 친환경적이고 작업자의 사용에 안전한 원료로 사용되고 있습니다.

추가 정보 문의는 아래의 연락처로 문의 하십시오
Email : hc@hccorp.kr / Tel : 02-515-6671



솔더 팔레트, 농축 트랩, 및 공구 세척

제스트론은 솔더 팔레트, 농축 트랩, 캐리어, 솔더 오븐, 디스펜싱 니들, 스퀴지, 코팅 프레임 및 기타 장비 부착품에 묻어있는 굳은 플럭스 제거와 솔더링 공정으로부터 야기된 솔더페이스트와 SMT 접착제를 조립품에서 제거하기 위해 수계 기반, 계면활성제 기반, 용제 기반의 세척제 제품 라인을 제공합니다.

제품 기술	세척제	세척 용도						세척 공정 타입				
		농축 트랩 필터	솔더 팔레트, 프레임, 캐리어	장비 부착품	리플로우 오븐, 웨이브 솔더링 시스템	코딩 프레임 노	스프레이	초음파	침전형 스프레이매뉴얼용			
FAST® (수계 기반, 계면활성제)	ATRON® SP 200	●	●	●				●	●	●		
	ATRON® SP 300	●	●	●				●	●	●		
	ATRON® SP 400	●	●	●				●		●		
수계 기반	ATRON® DC					●	●	●	●			
MPC® (수계 기반)	VIGON® RC 303		●	●								●
	VIGON® SC 210				●				●			
Solvent (솔벤트 기반)	ZESTRON® HC				●							●

- 세척제 전용 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션을 위해 특별히 개발된 세척제 제품
- 적용 가능한 세척제 어플리케이션 - 이 세척 어플리케이션에 사용될 수 있는 세척제 제품

세척 응용 제품 및 이점



솔더 팔레트 / 캐리어 트레이

PCB 의 정확한 로딩을 위해, 솔더 오븐의 최적 공정을 맞추고 조립 시 균일하지 않은 솔더링 결과
과가 나오지 않게 하기 위해서는 솔더 팔레트나 캐리어 트레이에 묻어있는 심하게 연소된 플럭스
잔류물을 반드시 제거해야 됩니다. 제스트론의 수계 기반 세척제는 뛰어난 세척 성능과 재료 호
환성을 가지고 있으며 일반적 계면활성제보다 3~10배 긴 Bath 수명을 가지고 있습니다.



농축 트랩

솔더링 과정 중 솔더 페이스트에서 나오는 가스 및 증기로 인해 축적된 응고물들은 솔더 오븐의
열 전달을 방해하여 솔더링 결과에 악영향을 미칠 수 있습니다. 스프레이나 침전형 스프레이 세척
장비를 이용한 세척 공정에서 제스트론의 수계 기반 세척제를 사용하여 농축 트랩을 정기적으로
유지보수 함으로써 모든 유형의 오염물이 완전히 제거되도록 합니다.



리플로우 오븐 / 웨이브 솔더 시스템

솔더 오븐의 내부 표면은 증발된 플럭스와 솔더링 시 발생된 가스로 인해 오염이 됩니다. 제스트
론의 솔더 오븐 전용 세척제는 사용시 최고 수준의 작업자의 안전성을 보유함과 동시에 효과적인
세척 성능을 보입니다. 또한 인화점이 없으며 유해한 물질이나 포함하고 있지 않아 친환경적이고
열이 있거나 차가운 표면에도 세척제를 도포할 수 있습니다.



디스펜싱 니들

디스펜싱 바늘을 세척 시에는 에폭시 레진이나 SMT 접착제와 같은 에폭시 접착제를 반드시 제거
해야 됩니다. 디스펜싱 바늘과 관련 도구를 세척 시 초음파 침전 방식의 자동화 세척기나 매뉴얼
로 수행할 수 있습니다. 제스트론은 잔사 없이 건조가 빠른 모던 용제기반의 세척제를 제공하고
있으며 이 세척제는 접착제 잔류물들을 제거할 수 있게 개발되었습니다.

환경, 보건, 및 안전 규정



모든 제스트론 세척제는 RoHS I, II & III/WEEE, GHS/CLP 및 REACH 를 준수하며
SVHC 또는 S.I.N. 목록에 있는 물질을 포함하고 있지 않습니다. 저희 세척제는 가장 친환경적이고
작업자의 사용에 안전한 원료로 사용되고 있습니다.

추가 정보 문의는 아래의 연락처로 문의 하십시오
Email : hc@hccorp.kr / Tel : 02-515-6671



(주)에치씨코퍼레이션

Tel. 02-515-6671

hc@hccorp.kr

www.hccorp.kr